

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年7月21日(21.07.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/153794 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 27/00 (2006.01) C09J 7/20 (2018.01)
B32B 27/30 (2006.01) C09J 7/29 (2018.01)
C09J 133/00 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 133/14 (2006.01) B32B 7/022 (2019.01)
H01L 21/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/047062
- (22) 国際出願日: 2021年12月20日(20.12.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-005780 2021年1月18日(18.01.2021) JP
- (71) 出願人: A G C 株式会社 (AGC INC.) [JP/JP];
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 竹中 聡史 (TAKENAKA, Satoshi);
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 A G C 株式会社内 Tokyo (JP). 小寺

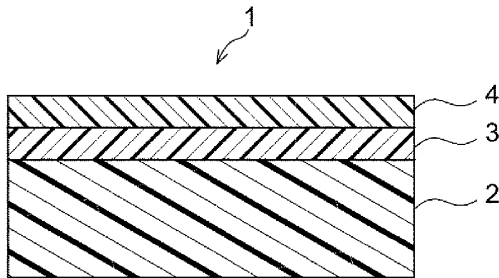
省吾 (KOTERA, Seigo); 〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 A G C 株式会社内 Tokyo (JP). 長谷川 哲也 (HASEGAWA, Tetsuya); 〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 A G C 株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人太陽国際特許事務所 (TAIYO, NAKAJIMA & KATO); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: FILM, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称: フィルム及び半導体パッケージの製造方法



(57) Abstract: Provided are: a film comprising a substrate, a base layer, and an adhesive layer in the stated order, the base layer including a cured reaction product of a (meth)acrylic polymer and a curing agent, and the rate of elongation of the base layer, which is derived using the formula (rate of elongation (%))=(elongation (mm) during breakage) × 100/(distance (mm) between grippers before stretching), being 90% or greater as measured at a temperature of 25 ° C and a speed of 100 mm/min through a stretching test; and a method for manufacturing a semiconductor package in which the aforementioned film is used.

(57) 要約: 基材と、下地層と、粘着層と、をこの順に備え、前記下地層は、(メタ)アクリル重合体と硬化剤との反応硬化物を含み、引張試験により、25℃、速度100mm/分で測定され、下記式で求められる前記下地層の伸び率が90%以上であるフィルム: 伸び率 (%) = (破断時の伸度 (mm)) × 100 / (引張前のつかみ具間距離 (mm))、及び当該フィルムを用いた半導体パッケージの製造方法。

WO 2022/153794 A1

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))